Embedded Module mit i.MX8M Mini

Open Standard Module™ - iesy i.MX8M Mini OSM-SF

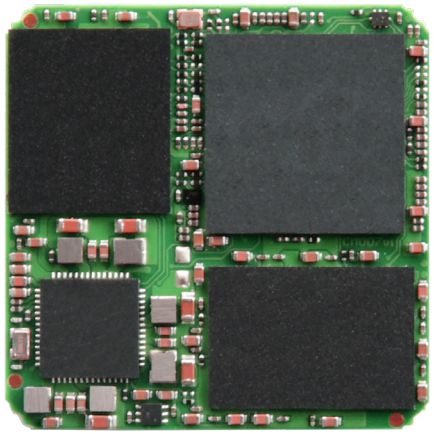
Technisches Konzept

▶ Prozessor:	i.MX8M Mini Cortex-A53 Quad Core + Cortex-M4 MCU
▶ Taktrate:	1,6 GHz (A53) + 400 MHz (M4)
▶ Arbeitsspeicher:	1 GByte LPDDR4
▶ Flash Speicher:	16 GByte e-MMC 5.1
▶ Abmessung:	30 mm x 30 mm
▶ Footprint:	OSM Size-S Land Grid Array (LGA) mit 332 Kontakten
▶ Spannungsversorgung:	Single Supply 5VDC
▶ Temperaturbereich:	
> Im Betrieb:	-40 °C bis +85 °C
> Lagerung:	-40 °C bis +85 °C
▶ Leistungsaufnahme:	1,3 W (typ.) / 3,4 W (max.)

▶ Funktionen & Schnittstellen

- > 1 x LAN 10/100/1000 (RGMII)
- > 1x PCIe x1 (incl. I2C/SMBUS)
- > 2x USB 2.0 Client/Host/OTG
- > 1x MIPI DSI (4 Lanes)
- > 1x MIPI CSI (4 Lanes, incl. I2C)
- > 1x SD-Card, 1x SDIO/MMC (8 bit)
- > 1x QSPI, 1x SPI, 3x UART, 1x Debug-UART
- > 2x I2C, 1x I2S (2x TX/RX)
- > 24x GPIO, 3x PWM
- > 1x JTAG

iesy GmbH I Meinerzhagen I Germany I +49 (2354) 70655 0 I sales@iesy.com I www.iesy.com



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität, Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.

iesy.com/osm